



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934

No. 175]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2012

विषय: इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योगों के लिए निवेश को आकर्षक करने और बाधाओं को दूर करने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)।

सं. 24(10)/2010-आईपीएचडब्ल्यू.—1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य :

1.1 देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण आधार ऐसे माल की मांग की तुलना में अपर्याप्त है। यहां तक कि ऐसे मामलों, जहां भारत में उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है, में घरेलू मूल्य वृद्धि की सीमा कम है। सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के प्रमुख अंग होते हैं और ये सामग्री के बिल (बीओएम) के कुल मूल्य के अधिकांश भाग के रूप में होते हैं। सेमीकंडक्टर, संघटकों के विनिर्माण के लिए निवेश को आकर्षक करने तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाएं विद्युत की उच्च लागत और वित्त पोषण, उच्च लेनदेन लागत तथा आपूर्ति श्रृंखला (संघटक और अनुषंगी पुर्जों) का कमजोर आधार से संबंधित हैं। वर्तमान में सेमीकंडक्टर वेफर, सेमीकंडक्टर और ज्यादातर उच्च तकनीकी संघटकों का आयात किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और उन्हें लगातार परिवर्तित होने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखला का विकास उच्चतर घरेलू मूल्य वृद्धि वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक है। अतः सरकार ने इन बाधाओं को

न्यूनतम करने के लिए एक साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण समूहों (ईएमसी) को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक निवेश को आकृष्ट करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज देने का निश्चय किया है।

1.2 आईटी/आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण पर कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ईएसडीएम उद्योग अन्य देशों में अपने समकक्ष उद्योगों से पीछे हैं जबकि उनके पास चिप डिजाइन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में अपनी सामर्थ्य के कारण इस क्षेत्र के विकास हेतु आधारभूत क्षमताएं उपलब्ध हैं। प्रस्तावित प्रोत्साहन से एक समकक्ष स्तर उपलब्ध होगा और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य हासिल होगा।

1.3 भारत में ईएसडीएम उद्योग के समक्ष जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अवसंरचनात्मक कमियों के परिणामस्वरूप उच्च लेन-देन लागत जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान हैं। भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय निर्यातकों द्वारा दी जाने वाली लेन-देन संबंधी लागतों सहित लागत अक्षमताएं अलग-अलग हैं तथा ये 19 से 22% की रेंज में हैं। इसके विपरीत विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में निर्यातक लेन-देन लागतों का केवल 2 से 3% का ही भुगतान करते हैं। संशोधित एसआईपीएस उपर्युक्त और अन्य समस्याओं को काफी हद तक कम करने का एक प्रयास है।

## 2. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज:

2.1 एम-सिप्स सभी नयी ईएसडीएम यूनिटों और मौजूदा ईएसडीएम यूनिटों के क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए गए निवेश के संबंध में लागू होगी। योजना के उद्देश्य से:-

क) ईएसडीएम यूनिट का आशय किसी ऐसी यूनिट से है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों तथा अनुबंध -2 में सूचीबद्ध सहायक पुर्जों के डिजाइन और विनिर्माण में संलग्न है। इसमें इन उत्पादों के विकास और कच्चे माल से लेकर सहायक पुर्जों के विनिर्माण में शामिल मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल हैं। इसमें असेम्बली, परीक्षण और पैकेजिंग शामिल हैं। इसमें उपर्युक्त चरणों में से किसी भी चरण में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ (ईएमएस) भी आते हैं।

ख) किसी मौजूदा यूनिट के विस्तार का आशय किसी ईएसडीएम यूनिट द्वारा क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के उद्देश्य से अपने प्लांट और मशीनरी में 25% से अधिक का निर्धारित पूंजी निवेश बढ़ाना माना जाएगा।

2.2 संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध होगा।

2.3 योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में आने वाली यूनिटों के लिए लागू निवेश मार्ग अनुबंध -1 में दिए गए हैं। वर्तमान यूनिटों की विविधता और क्षमता/आधुनिकीकरण के विस्तार या नयी यूनिटों के लिए मार्ग समान हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों को अनुबंध -1 में भी दर्शाया गया है।

3.1 अनुबंध -1 में उल्लिखित प्रोत्साहन किसी यूनिट के अनुमोदन से 10 वर्ष के भीतर किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होंगे। वर्तमान यूनिटों की क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधता के विस्तार के मामले में, वर्तमान यूनिटों की क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधता के अनुमोदन के 10 वर्ष के भीतर किए गए निवेश के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

3.2 राज्य सरकार अथवा इसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन, यदि कोई हैं, एम-सिप्स के अंतर्गत पात्र प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होंगे।

3.3 10 वर्ष की समयावधि परियोजना के अनुमोदन के बाद पहले 10 वर्ष की होगी न कि परियोजना के किसी आगामी चरण की शुरुआत से 10 वर्ष।

3.4 पूंजीगत व्यय अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) सहित भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी में कुल पूंजीगत व्यय माना जाएगा। इस संदर्भ में प्रोत्साहनों की गणना के लिए भूमि की कुल लागत पर पूंजीगत व्यय के 2% से अधिक होने की स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.1 पूंजीगत व्यय की तुलना में प्रोत्साहन राशि उस वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात जारी की जाएगी जिसमें कुल निवेश मार्गस्थ मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है। इसके पश्चात प्रोत्साहन वर्ष के दौरान किए गए निवेश के मूल्य पर वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा और यह इस योजना के अंतर्गत यूनिट के अनुमोदन की तारीख से पहले 10 वर्ष तक ही सीमित होगा।

4.2 वास्तविक रूप से भुगतान किए गए केन्द्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति, जहां कहीं भी लागू है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात जारी की जाएगी जिसमें यूनिट अपना उत्पादन शुरू करती है। इसके पश्चात प्रोत्साहन वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों के मूल्य पर वार्षिक आधार पर उपलब्ध होगा और यह यूनिट की पात्रता के अनुमोदन की तारीख से पहले 10 वर्ष तक ही सीमित होगा।

5.1.1 संशोधित एसआईपीएस के अंतर्गत समग्र वित्तीय सीलिंग शुरुआत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,000 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में योजना का सर्वेक्षण

13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संभावित मांगों का वास्तविक अनुमान लगा सकता है।

5.1.2 सूचीबद्ध उत्पाद और थ्रेहाहोल्ड, जिनके लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, उनमें यदि कुछ बदलाव हैं, तो उनके संबंध में आवधिक सर्वेक्षण किए जाएंगे।

5.2 संशोधित एसआईपीएस इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में लागू होगी। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निरंतर आधार किया जाएगा।

5.3 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर के तहत स्थापित यूनिटों के लिए संशोधित एसआईपीएस उपलब्ध होंगे।

6.1 अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक संशोधित एसआईपीएस मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। यदि अपर सचिव लंबी छुट्टी पर हैं अथवा उस पद के रिक्त होने के कारण, उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में दूसरा कोई अधिकारी जिसका रैंक अपर सचिव के रैंक से कम न हो, प्रभारी मंत्री, द्वारा जिन्हें प्राधिकृत किया जाए, समिति की अध्यक्षता करेगा। यह मूल्यांकन समिति संशोधित एसआईपीएस के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। सरकार ऐसी सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात अपना अनुमोदन प्रदान करेगी।

6.2 संशोधित एसआईपीएस मूल्यांकन समिति के प्रभावी ढंग से कार्य संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार और अलग से जारी किया जाएगा।

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

## अनुबंध -1

## ईएसडीएम के लिए निवेश मार्ग और वित्तीय प्रोत्साहन

क्र.सं.	प्रकार	निवेश मार्ग (करोड रुपये)			वित्तीय प्रोत्साहन	
		फैब	असम्बली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)	विनिर्माण	एसईजेड	गैर- एसईजेड
1.	अनुबंध-2 के अनुसार नैनो इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद	-	-	10	केपेक्स का 20%	केपेक्स का 25% + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
2.	मध्यस्थ					
2.1	नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक	-	-	200	केपेक्स का 20%	केपेक्स का 25% + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
2.2	सेमीकंडक्टर वेफरिंग	-	-	1000	केपेक्स का 20%+ केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट- 1 देखें)	केपेक्स का 25% + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट- 1 देखें)
2.3	सेमीकंडक्टर चिप (नोट 2 देखें):					
(क)	लाजिक- माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) और विशिष्ट अनुप्रयोग एकीकृत परिपथ (एएसआईसीएस)।	2000	500	लागू नहीं	केपेक्स का 20 % + केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट-1 देखें)	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट-1 देखें)

(ख)	मेमोरी	5000	400	लागू नहीं	केपेक्स का 20 % + केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट-1 देखें)	• केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट-1 देखें)
2.3	चिप कंपोनेन्ट, डिसक्रीट सेमीकंडक्टर और पावर सेमीकंडक्टर:					
(क)	चिप कम्पोनेन्ट	200	75	लागू नहीं	केपेक्स का 20% प्रतिशत	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
(ख)	ट्रांजिस्टर, डायोड इत्यादि जैसे डिसक्रीट सेमीकंडक्टर	25	10	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25% + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
(ग)	एफईटी, एमओएसएफईटी, एससीआर, जीटीडी, आईजीबी टी इत्यादि की तरह का पावर सेमीकंडक्टर (विसरण सहित)	100	50	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
2.4	सोलर फोटोवोल्टाईक (एसपीवी) (नोट-3 देखें):					
(क)	पोलीसिलिकोन प्रौद्योगिकी:					
i)	पोलीसिलिकोन	650	लागू नहीं	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति

ii)	इनगोट्स और/अथवा वेफर	400	लागू नहीं	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
iii)	सेल्स अथवा सेल्स और माड्यूल्स	100	लागू नहीं	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति (नोट-3 देखें)
(ख)	थिन फिल्म प्रौद्योगिकी					
i)	सेल्स अथवा सेल्स और माड्यूल्स	300	लागू नहीं	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
2.5	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)	250	50	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
2.6	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी)					
(क)	एलसीडी फेब्रिकेशन	4000	250	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + केन्द्रीय करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति (नोट-1 देखें)
(ख)	एलसीडी ग्लास सबस्ट्रेट	250	100	लागू नहीं	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति

2.7. पैसिव कंपोनेन्ट, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कम्पोनेन्ट, मैकेनिकल पार्ट और उपभोग्य सामग्री और उपकरण :						
(क)	रजिस्टर, केपेसीटर, इंडक्टर थर्मिस्टर इत्यादि की तरह का पैसिव कम्पोनेन्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	5	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
(ख)	मल्टीलेयर पीसीबी, ट्रांसफार्मर, कायल, कनेक्टर, स्वीच, फेराइट, माइक्रो मोटर, स्टेपर मोटर, फिल्म इत्यादि की तरह के इलेक्ट्रोमैकेनिकल कम्पोनेन्ट और मैकेनिकल पार्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	5	केपेक्स का 20 प्रतिशत	केपेक्स का 25 प्रतिशत + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
(ग)	मोबाइल फोन और आइटी उपकरण-बैट्री, चार्जर इत्यादि, पीसीबी, फायल, टेप, इपॉक्सी, कैबिनेट इत्यादि जैसी उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण	लागू नहीं	लागू नहीं	1	केपेक्स का 20 %	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
3.	इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं (ईएमएस)-(नोट-4 देखें)	लागू नहीं	लागू नहीं	100	केपेक्स का 20%	केपेक्स का 25 % + पूंजी उपकरण पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति

नोट-1: केन्द्रीय शुल्क और कर का अर्थ है: उत्पादन निधि के प्रारंभ होने की तिथि से वस्तुओं पर सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क।



**नोट-2:** सेमीकंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन सुविधा (फैब) की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्राप्त फैब के प्रकारों का निर्णय अलग कार्य के रूप में सरकार द्वारा दो फैबों की स्थापना के लिए आकर्षित किए जा रहे निवेश के परिणाम पर आधारित होगा।

**नोट-3:** अतिरिक्त सोलर फोटोवोल्टाईक में निवेश के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय दिनांक 21 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 3(1)/2007- आईपीएचडब्लू (एसआईपीएस) द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एसआईपीएस) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परिणामों पर आधारित होगा।

**नोट-4:** इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) का तात्पर्य ओरिजिनल इक्विपमेन्ट मैन्युफैक्चरर (ओईएम) को एकीकृत सेवाओं सहित सब-असेम्बलियों और कल-पुर्जों के विनिर्माण से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने में संलग्न यूनिटों से होगा। परन्तु ईएमएस को अपने ब्राण्ड नाम के अंतर्गत अंतिम उत्पादों के उत्पादन को शामिल नहीं करना चाहिए।

#### अनुबंध -2

ईएसडीएम के वर्टिकलों की सूची, जिनके लिए एम-एसआईपीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

क)	नैनो-इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों और टेलीकाम उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादः (अनुबंध 1 की क्रम संख्या 1)
1.	ऑप्टिकल फाइबर उपकरण सहित टेलीकाम उत्पाद; टैरेस्ट्रियल संचार उपकरण; उपग्रह संचार उपकरण; सार्वजनिक और निजी नेटवर्क के लिए L2 और L3 स्वीच सहित आईपी आधारित नई पीढ़ी का साफ्ट स्वीच/राउटर, डेटा नेटवर्किंग उपकरण-कॉपर/ऑप्टिकल-उपभोक्ता और कैरियर ग्रेड; परिवहन प्रणाली-डीडब्लूडीएम, एसडीएच, पीओएन, क्रास-कनेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आरएफ, कैरियर इथरनेट, पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्लेटफार्म (पी-ओटीपी); वायरलेस प्रौद्योगिकी जीएसएम ( 2जी और 2.5 जी) सीडीएमए, 3जी, एलटीई और उन्नत, एलटीई, वाई-फाई, वाईमेक्स और उन्नत वाईमेक्स; माइक्रोवेव रेडियो प्रणाली 2-70 जीएचजेड, साफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, कागनितिव रेडियो, वितरित एंटीना प्रणाली; सुरक्षा और निगरानी से संबंधित उपकरण, स्पीच, डेटा, इमेज, विडियो का संसाधन; ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई)- पीबीएक्स प्रणालियां, इडेन्ड्स, 3जी राउटर, वीओआईपी गेटवे, आवासीय गेटवे, पहुंच बिन्दु, राउटर, ब्राडबैंड सीपीई, मोबाइल फोन। मोबाइल हैंडसेट/स्मार्ट मोबाइल फोन, सेट-टाप बाक्स, एचएमओडीएमएस, डांगल्स, डेटा कार्ड, शार्ट रेन्ज डिवाइसेस ( एसआरडी, सेंसर; वीएसएटी आधारित प्रणालियां-ब्राडबैंड, आपदा प्रबंधन; गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, हैंडसेट के लिए पोर्टेबल मिकेनिकल चार्जर, कम्प्यूटर, उपर्युक्त सभी के लिए एनएमएस/ओएसएस/बीएसएस प्रणालियां- एसएनएमपी/ओपनव्यू/सीओआरबीए, ग्राहक सेवा तथा बिलिंग प्रणालियां; ऊर्जा प्रबंधन, एलआई-आईओएन जैसा उन्नत संग्रहण बैटरी, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण इत्यादि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद।

2.	कम्प्यूटर, (टेबलेट, डेस्कटाप इत्यादि) सर्वर, पेरिफेरल लाइक प्रिंटर, फैक्स, संग्रहण डिवाइसेस मानिटर इत्यादि सहित आईटी हार्डवेयर
3.	टेलिविजन, डिजिटल कैमरा, कैमकार्डर इत्यादि जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी
4.	स्वास्थ्य और चिकित्सकीय इलेक्ट्रॉनिकी
5.	सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी
6.	थिन फिल्म, पोलिसिलिकन इत्यादि सहित सोलर फोटो वोल्टाईक
7.	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)
8.	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी)
9.	एवियोनिक
10.	मापन एवं नियंत्रण उपकरण, ऊर्जा मीटर इत्यादि सहित औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं
11.	नैनो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
12.	ई-अपशिष्ट संसाधन/ रिसाइक्लिंग
13.	एण्टी लाक ब्रेकिंग प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वितरण, ट्रेक्सन नियंत्रण इत्यादि जैसा आटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी
14.	एग्री-इलेक्ट्रॉनिकी
15.	ऊर्जा संरक्षण इलेक्ट्रॉनिकी
16.	आप्टा-इलेक्ट्रॉनिकी
17.	वायो-मीट्रिक एवं पहचान डिवाइसेस/आरएफआईडी
18.	ईएसडीएम उत्पादों के लिए ऊर्जा आपूर्ति
(ख)	मध्यस्थ: (अनुबंध-1 की क्र. संख्या -2)
1.	नैनो-इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट
2.	सेमीकंडक्टर वेफरिंग
3.	लाजिक, मेमोरी और एनालॉग सहित सेमीकंडक्टर चिप
4.	ईएसडीएम एककों का सभी असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग
5.	चिप कंपोनेंट

6.	ट्रांजिस्टर, डायोड जैसा डिसक्रिट सेमीकंडक्टर
7.	एफईटी, एमओएसएफईटी, एससीआर, जीटीडी, आईजीबीटी इत्यादि जैसा विद्युत सेमीकंडक्टर (विसरण सहित)
8.	मल्टीलेयर पीसीबी, ट्रांसफार्मर, कायल, कनेक्टर, स्वीच, फेराइट, माइक्रो मोटर, स्टेपर मोटर, फिल्म इत्यादि जैसा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंपोनेंट और मिकेनिकल पार्ट
9.	मोबाइल फोन और आईटी उपकरण-बैट्री, चार्जर इत्यादि, पीसीबी, फायल, इपॉक्सी, कैबिनेट इत्यादि जैसे उपभोग्य वस्तुएं एवं उपकरण
10.	ईएसडीएम उत्पादों के लिए सभी फेब्रिकेशन विनिर्माण सुविधा (फैब)
	नोट: स्कीम के अंतर्गत उपर्युक्त में शामिल नहीं किए गए मध्यस्थों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा एवं अनुमति दी जाएगी।
(ग)	इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सेवाएं (ईएमएस) (अनुबंध-1 की क्र. संख्या -3)

\*\*\*\*\*

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY****(Department of Electronics and Information Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2012

**Subject : Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) to offset disability and attract investments in Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) Industries.**

**No. 24(10)/2010-IPHW.—1. Background and Objective :**

1.1 Manufacturing base of electronic products in the country is grossly inadequate in comparison to demand of such goods. Even in cases where products are manufactured in India, the extent of domestic value addition is low. Semiconductors are at the heart of any electronic systems and constitute a significant part of the total value of the Bill of Material (BOM). The main impediments in the way of attracting investments for manufacture of semiconductors, components and electronic products are disabilities like high cost of power and finance, high transactional costs and poor base of supply chain (components and accessories). Presently, semiconductor wafers, semiconductors and majority of the hi-tech components are being imported. The manufacturing capabilities for semiconductors are highly capital intensive and have to deal with constantly changing technology. Development of supply chain is essential for the manufacture of electronic products with higher domestic value addition. Therefore, Government has decided to offer a

package of incentives to attract domestic and global investments into the Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) sector within Electronics Manufacturing Clusters (EMCs) as a means to minimizing the disabilities.

1.2 As per the report of the Task Force on IT/ITES and Electronics Hardware Manufacturing, the ESDM industry in India lags behind its counterparts in other countries despite having basic capabilities to develop the sector due to its strength in chip design and embedded software. The proposed incentives will provide a level-playing field and achieve competitiveness in the global market.

1.3 ESDM industry in India faces significant challenges like high transactional costs, complex administrative processes and infrastructural deficiencies. An analysis by the Federation of Indian Export Organization (FIEO) reveals that cost disabilities, including the transaction costs borne by Indian exporters vary and range from 19 to 22%. In contrast exporters in developed economies pay only 2 to 3% of transactional costs. The Modified SIPS proposes to partly offset the difficulties.

## **2. Modified Special Incentive Package:**

2.1 The M-SIPS will be applicable to investments in new ESDM units and expansion of capacity/ modernization and diversification of existing ESDM units. For the purpose of the scheme -

- a) ESDM unit shall mean a unit engaged in design and manufacturing of the electronics and nano-electronics products and their accessories listed in **Annexure – 2** and includes all stages of the value-chain involved in the development of these products and accessories starting from raw materials. It includes assembly, testing and packaging. It also includes Electronics Manufacturing Services (EMS) involved in any of the above stages.
- b) Expansion of an existing unit would mean increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an ESDM unit by not less than 25%, for the purposes of expansion of capacity/ modernization and diversification.

2.2 The Modified Special Incentive Package shall be for state-of-the-art technology.

2.3 The investment thresholds applicable for units in different categories under the scheme are indicated in Annexure - 1. The thresholds are the same

for new or expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units. The incentives available for each category are also indicated along with in Annexure - 1.

3.1 The incentives mentioned in Annexure - 1 will be available for investment made within 10 years of the approval of a new unit. In case of expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units, the incentive will be available for investment made within 10 years of the approval of expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units

3.2 The incentives, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies shall be over and above the incentive amount eligible under M-SIPS.

3.3 The period of 10 years shall be the first 10 years after the approval of the project and not with regard to any subsequent phase/s of the project.

3.4 The capital expenditure will be the total of capital expenditure in land, building, plant and machinery and technology including Research and Development (R&D). The total cost of land exceeding 2% of the capital expenditure shall not be considered for calculation of incentives in this regard.

4.1 The incentive against the capital expenditure shall be released after the end of the financial year in which the total investment exceeds the threshold value. Thereafter, the incentive shall be provided on an annual basis on the value of the investments made during the year and be restricted to the first 10 years from the date of approval of the unit under the scheme.

4.2 The re-imbursement of Central taxes and duties actually paid, where applicable, shall be released after the end of the financial year in which the unit commences the production. Thereafter, the incentive shall be provided on an annual basis on the value of the taxes and duties actually paid during the year and will be restricted to the first 10 years from the date of approval of the unit.

2844 GI/12-4

5.1.1 The overall financial ceiling under the Modified SIPS will initially be limited to Rs 10,000 crores during the 12<sup>th</sup> Five Year Plan. A review of the scheme in the ultimate year of the 12<sup>th</sup> Five Year Plan could make a realistic estimate of the likely demand for the 13<sup>th</sup> Five Year Plan.

5.1.2 Periodic reviews will be undertaken with respect to changes, if any, to the list of products and thresholds for which incentives are provided.

5.2 The M-SIPS will be open for applications for three years from the date of this notification. The applications received under the scheme will be appraised on an ongoing basis.

5.3 The M-SIPS will be available for units set up within Electronics Manufacturing Clusters to be notified by the Department of Electronics and Information Technology.

6.1 An M-SIPS Appraisal Committee shall be set up by the Department of Electronics and Information Technology and headed by the Additional Secretary, Department of Electronics and Information Technology or in his absence on long leave or the post being vacant any other officer in the Department not below the rank of Additional Secretary, who may be so authorized by the Minister incharge. The Appraisal Committee will consider the applications under M-SIPS and submit its recommendations to the Government. The Government shall consider such recommendations and grant approvals.

6.2 For effective functioning of the M-SIPS Appraisal Committee, a set of guidelines shall be drawn up by Department of Electronics and Information Technology and issued separately.

Dr. AJAY KUMAR. Jt. Secy.

## Annexure 1

## Investment Thresholds and Financial Incentives for ESDM

S. No.	Type	Investment Threshold (in Rs. Crores)			Financial Incentives	
		Fab	Assembly, Testing, Marking & Packaging (ATMP)	Manufacturing	SEZ	Non-SEZ
1.	Electronic Products including Nano-Electronic and Telecom Products as per Annexure 2	-	-	10	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.	Intermediates					
2.1	Nano Electronic Components	-	-	200	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.2	Semiconductor Wafering	-	-	1000	20% of Capex + Reimbursement of Central Taxes and Duties (See Note - 1)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + Reimbursement of Central Taxes and Duties (See Note - 1)
2.3	Semiconductor Chips (See Note 2):					
a)	Logic – Microprocessors,	2000	500	N.A	20% of Capex +	25% of Capex + Reimbursement of

	Microcontrollers, Digital Signal Processors (DSP) & Application Specific Integrated Circuits (ASICs).				Reimbursement of Central Taxes and Duties (See Note - 1)	Excise/CVD on capital equipment + Reimbursement of Central Taxes and Duties (See Note - 1)
b)	Memory	5000	400	N.A	20% of Capex + Reimbursement of Central Taxes and duties (See Note - 1)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + Reimbursement of Central Taxes and Duties (See Note - 1)
2.3	Chip Components, Discrete Semiconductors and Power Semiconductors:					
a)	Chip Components	200	75	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
b)	Discrete Semiconductors like Transistors, Diodes etc.	25	10	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
c)	Power Semiconductors (including Diffusion) like FETs, MOSFETs, SCR's, GTDs, IGBTs etc.	100	50	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment



2.4	Solar Photovoltaics (SPV) (See Note - 3):					
a)	Polysilicon Technology:					
i)	Polysilicon	650	N.A	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
ii)	Ingots and/ or wafers	400	N.A	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
iii)	Cells or Cells & Modules	100	N.A	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment (See Note - 3)
b)	Thin Film Technology					
i)	Cells or Cells & Modules	300	N.A	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.5	Light Emitting Diodes (LED)	250	50	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.6	Liquid Crystal Displays (LCD):					
a)	LCD Fabrication	4000	250	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment +Reimbursement of Central Taxes and Duties (See Note - 1)
b)	LCD Glass Substrate	250	100	N.A	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on

						capital equipment
2.7.	Passive Components, Electro - Mechanical Components, Mechanicals Parts and Consumables & Accessories:					
a)	Passive Components such as Resistors, Capacitors, Inductors, Thermistors etc.	N.A	N.A	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
b)	Electromechanical Components and Mechanical Parts such as Multilayer PCBs, Transformers, Coils, Connectors, Switches, Ferrites, Micro Motors, Stepper Motors, Films etc.	N.A	N.A	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
c)	Consumables and Accessories such as Mobile Phones and IT accessories - Batteries, Chargers etc., PCBs, Foils, Tapes, Epoxy, Cabinets etc.	N.A	N.A	1	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
3.	Electronic Manufacturing	N.A	N.A	100	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of

Services (EMS) – (See Note – 4)					Excise/CVD on capital equipment
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------

**Note - 1:** Central Taxes and Duties mean Customs Duty, Service Tax, Excise Duty, on actual from the date of commencement of production.

**Note – 2:** The types of fabs for which incentives are available for setting up of Semiconductor Wafer Fabrication facilities (Fabs) will be decided based on the outcome of investment being attracted by the Government to set up two Fabs in a separate exercise.

**Note – 3:** Incentives for investments in additional Solar Photovoltaics shall be decided based on the outcome of proposals received under the Special Incentive package Scheme (SIPS) announced vide Notification No. 3 (1)/ 2007 – IPHW (SIPS) dated 21 March 2007.

**Note – 4:** **Electronic Manufacturing Services (EMS)** would mean, units engaged in providing services related to manufacture of sub-assemblies and parts including integration services to the Original Equipment Manufacturers (OEMs). However, EMS shall not encompass production of final products under their own brand name.

\*\*\*\*\*

## **Annexure 2**

### **List of verticals of ESDM for which incentives are available under M-SIPS**

(A)	<b>Electronics Products including Nano-Electronics Products and Telecom Products (Sl no. 1 of Annexure 1):</b>
1.	<b>Telecom products</b> including Optical Fiber Equipment; Terrestrial Communication Equipment; Satellite Communication Equipment; IP based new generation soft-switches/routers including L2 and L3 switches, data networking equipment – copper/optical – consumer and carrier grades, for public and private networks; Transport systems – DWDM, SDH, PON, Cross-connects, RF over optical fibre, Carrier Ethernet, Packet Optical Transport Platform (P-OTP); Wireless technology – GSM (2G & 2.5G), CDMA, 3G, LTE & LTE Advance, Wi-Fi, WiMAX & WiMAX Advance; Microwave Radio systems 2-70 GHz, Software defined radio, Cognitive radio, Distributed antenna systems; Equipment related to security and surveillance, processing of speech, data, image, video; Customer Premises Equipment (CPE) – PBX systems, eadends, 3G Routers, VoIP gateways, Residential gateways, Access points, Routers, Broadband CPEs, Mobile phones/ Mobile handsets/ Smart Mobile phones, Set-top boxes, HModems, dongles, data card; Short Range Devices (SRD), Sensors; VSAT based systems – Broadband, Disaster management; Non-conventional energy sources, portable mechanical chargers for handsets, computers; NMS/OSS/BSS systems for all above – SNMP/Openview/CORBA; Customer care & Billing systems; Electronics products for energy management, Advanced storage batteries such as Li-thium, Video Conferencing Equipment etc.

2844GI/12-6

2.	<b>IT Hardware</b> products including computers, (tablets, desktops etc.) servers, peripherals like printers, faxes, storage devices monitors, etc.
3.	<b>Consumer Electronics</b> like Televisions, Digital Cameras, Camcorders etc.
4.	<b>Health and Medical Electronics</b>
5.	<b>Strategic electronics</b>
6.	<b>Solar Photo Voltaic</b> including thin film, polysilicon etc.
7.	<b>Light Emitting Diodes (LEDs)</b>
8.	<b>Liquid Crystal Displays (LCDs)</b>
9.	<b>Avionics</b>
10.	<b>Industrial Electronic</b> products including measuring and control equipment, energy meters etc.
11.	<b>Nano electronic</b> products
12.	<b>e-waste processing/ recycling</b>
13.	<b>Automotive Electronics</b> like Anti-lock braking system, Electronic Brake Distribution, Traction Control, etc.
14.	<b>Agri-electronics</b>
15.	<b>Energy conservation electronics</b>
16.	<b>Opto-electronics</b>
17.	<b>Bio-metric and identity devices/ RFID</b>
18.	<b>Power supplies for ESDM products</b>
<b>(B)</b>	<b>Intermediates: (Sl no. 2 of Annexure 1)</b>
1.	<b>Nano-electronic</b> components
2.	<b>Semiconductor</b> wafering
3.	<b>Semiconductor</b> chips including logic, memory and analog
4.	<b>All Assembly, Testing, Marking and Packaging of ESDM Units</b>
5.	<b>Chip</b> components
6.	<b>Discrete Semiconductors</b> like Transistors, Diodes
7.	<b>Power semiconductors</b> (including diffusion) like FETs, MOSFETs, SCRs, GTDs, IGBT etc.
8.	<b>Electromechanical Components and Mechanical Parts</b> such as Multilayer PCBs, Transformers, Coils, Connectors, Switches, Ferrites, Micro Motors, Stepper Motors, Films etc.,

9.	Consumables and Accessories such as Mobile Phones and IT accessories - Batteries, Chargers etc., PCBs, Foils, Tapes, Epoxy, Cabinets etc.
10.	All Fabrication Manufacturing facilities (Fabs) for ESDM products
	Note: Any intermediates not covered above shall be decided and permitted under the scheme by the Competent Authority.
C.	<b>Electronics Manufacturing Services (EMS) (Sl no. 3 of Annexure 1)</b>

\*\*\*\*\*